

证券简称：博敏电子

证券代码：603936

博敏电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	上海汐泰投资、上海瑞和投资、上海臻宜投资、招商证券、华泰证券
时间	2026年5月21日
地点	深圳市宝安区宝华路与海天路交汇处宝中卓越时代广场C座28层博敏电子前海办公室
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书：刘佳杰 董事长特助及投资者关系负责人：李小伟 证券事务代表：廖鹏

投资者关系活动主要内容介绍

一、经营情况简介：

2025 年，我国宏观经济总体稳中有进、承压前行，GDP 保持合理增长，内需逐步修复、产业升级持续推进，电子信息产业保持良好发展态势。PCB 行业呈现显著的结构分化特征，AI 算力基础设施建设进入爆发期，驱动高多层板、高频高速板、高阶 HDI 及封装基板等高端产品需求快速增长，成为行业增长的核心引擎。在此行业背景下，PCB 产业加速向具备技术壁垒、产能优势及客户资源的头部企业集中，高端化、差异化、一体化成为企业突围的核心路径。公司顺应行业发展趋势，近年来持续聚焦 AI 算力、汽车电子等高增长赛道，重点布局光模块 PCB、服务器主板、加速卡主板及电源板等高端产品，并前瞻性探索“PCB+陶瓷基板”融合技术在数据中心领域的应用。公司实现经营业绩扭亏为盈，更完成了高附加值赛道的战略卡位，形成技术迭代与市场拓展的良性循环，为公司可持续高质量发展奠定坚实基础。公司实现营业收入为 361,204.72 万元，比上年同期增长 10.59%，归属于上市公司股东的净利润为 661.17 万元，比上年同期增长 102.80%，主要得益于公司在 AI 算力和汽车电子等高附加值领域业务快速增长，带动 PCB 业务营收同比增长并推动销售毛利率上升 7.61 个百分点，合计贡献业务毛利增量 20,700.45 万元。

二、投资者问答

Q1：请问公司现有的产能布局情况及未来方向？

A1：

（1）梅州基地（以高多层板、HDI 板为主）：梅州老基地+创芯智造园

梅州基地 PCB 产品深耕服务器、交换机、加速卡、汽车电子等领域，梅州老基地产能利用率保持高位运行。为满足客户持续增长的订单需求，公司加快推进创芯智造园产能爬坡，创芯智造园（一期）已顺利通过核心客户审核认证并开始承接新增订单，2026 年产能逐步爬坡。

（2）江苏基地（以 HDI 板为主）：一期工厂+二期工厂
江苏基地一期工厂生产传统 HDI 产品，主要面向消费电

子领域；二期工厂产品线包括高端 HDI 板、载板等，主要面向光模块、消费电子、汽车电子等领域。未来二期工厂原 HDI 产线将实施技改，转为生产光模块 PCB（含 HDI、MSAP）。

（3）深圳基地（以高频高速板、搞多层、埋嵌及陶瓷基板为主）：PCB 工厂+陶瓷基板工厂

深圳基地 PCB 工厂侧重特色品领域，技术能力位于行业前列，拥有多项知识产权及成果鉴定，凭借其在高品质、高精密 PCB 领域多年的技术积累和沉淀，获得特色品资质方面的认证。同时掌握 PCB 埋嵌平台工艺与陶瓷基板技术。

Q2：请问公司光模块业务开展情况如何？未来又是如何看待光通信市场？

A2：光模块业务成为公司增长的核心亮点。公司充分发挥江苏博敏 HDI 产能与梅州基地高多层板产能的协同优势，已成功导入光模块头部厂商供应链体系。目前已实现 400G、800G 光模块 PCB 批量供货，同时积极推动 1.6T 光模块 PCB 量产工作。

着眼未来，随着光模块速率逐渐升级（400G→800G→1.6T→3.2T），将推动 PCB 层数从 10-12 层提升至 16-24 层，线宽线距持续缩小，光模块 PCB 生产工艺要求和价值量将随之提升。

Q3：AI 需求推动服务器、光模块等产品快速升级，随之产品要求和工艺难度不断提升，公司是否已有相应的技术储备？

A3：公司同时掌握 PCB 埋嵌平台工艺与陶瓷基板技术，牵头制定并发布了国内首部《埋置或嵌入铜块印制电路板规范》团体标准，填补了国内该领域技术标准空白。随着电动汽车与数据中心对功率密度、散热能力及可靠性要求的不断提升，PCB 埋嵌技术的应用场景持续拓展。在 AI 算力领域，随着算力芯片功率不断提升，传统 PCB 已难以满足散热与热膨胀系数匹配要求；公司成功实现 PCB 埋嵌氮化硅陶瓷基板在矿机类加速卡客户的打样验证，该技术可有效解决高功率芯片的散热难题。

Q4：公司下半年是否有融资规划？

A4：公司于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站披露的公司《2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-051），具体实施情况请以公司披露的公告为准。